

### 第28回 NEDIA アクションセミナー開催のご案内

NEDIA では、アクションセミナー委員会で、会員様向けに、タイムリー、かつ役立つ業界情報を提供し、会員様の価値向上を図るべく、革新的なアクションセミナーを企画し開催をしています。

第28回は、高い気密性や放熱性の実現に加え部品点数削減にも貢献できることから、電子デバイス封止技術の新潮流として注目を集めている異種材料接合技術について、ご講演いただきます。

新型コロナウイルス感染を防止するための対策も講じた上で開催いたします。ぜひ多くの会員様にご参加頂けることを心よりお待ちしております。

#### ———— 開催案内 ————

1. 開催日時：2021年3月24日（水）17:00～18:30

2. 開催場所：学士会館 203 室 東京都千代田区神田錦町 3-28 電話 03-3292-5936

最寄駅：地下鉄 神保町駅 出口 A9 から徒歩 1 分（都営新宿線・都営三田線・東京メトロ）

3. テーマ：電子デバイス産業に新たな道を拓く異種材料接合技術

#### <講演概要>

金属と異種材料を強固に接合する技術「DLAMP®」と、樹脂と樹脂同士を強固に接合する技術「AKI-Lock®」は、電子デバイスの封止技術の新潮流として注目を集めています。「DLAMP®」は、気密性の高い接合を実現できるうえ、フッ素樹脂やシリコンゴム等の難接着材料を容易に接合できます。「AKI-Lock®」も、これまで接合が困難であった樹脂と樹脂、樹脂と異材との接合が可能で、こちらも高い気密性が特徴です。また、これらは高い放熱性を実現できるうえ、部品点数削減によるコストダウンにも貢献します。今後、様々な電子デバイスでの活用が期待される注目技術です。今回は、これらの技術を開発し、多分野への展開を図っているダイセルミライズ㈱およびポリプラスチック㈱から講師をお招きし、異種材料接合技術の魅力を語っていただきます。さらに、ポリプラスチック㈱からは、同社が注力する 5G 本格化に向けた LCP 樹脂材料の新たな提案についても語っていただきます。

#### 4. 講師：

○ダイセルミライズ㈱ 事業推進本部 DLAMP 室 室長 清水 潔氏

○ポリプラスチック㈱ 営業本部 日本営業統括部 PLAMOS 事業推進部 主席部員

特級プラスチック成形技能士 宮崎 広隆氏

5. タイムテーブル：16：30～受付開始

17：00～18：15 セミナー

18：15～質疑応答（終了は 18：30 予定）

6. 参加費：NEDIA 会員 1,000 円、非会員 3,000 円

ご参加の申込みは、3月17日(水)までにメールにて事務局までお願い致します。

申込みを確認後、事務局より返信いたします。

定員になりましたら、申込みの受け付けを終了させていただきます。

7. 本セミナーにおける新型コロナウイルス感染防止について

(1) 会場及びスタッフの対応

- ・定員 72 名の会場において、間隔を確保するため、収容人員 30 名で実施します。
- ・演台と座席との間隔を確保します。
- ・スタッフはマスクを着用します。
- ・スタッフは発熱などの風邪の諸症状がある等、体調不調の場合は参加しません。

(2) 参加者様へのお願い事項

- ・発熱などの風邪の諸症状がある等、体調不調の場合は参加を控えていただきたくお願い致します。
- ・セミナー会場へのご入室時に、消毒液の使用及び検温へのご協力をお願いいたします。  
体温が 37.5 度以上の場合は、ご入場をお断りする場合がございます。
- ・会場では、マスクの着用をお願いいたします。
- ・間近での会話を避けるため、講師への質問は、セミナー時間内にお席にてお願い致します。

<事務局連絡先> E-mail : [info@nedia.or.jp](mailto:info@nedia.or.jp) TEL : 03-5823-4465 FAX : 03-5823-4475

以上